公司代码:688020　　公司简称:方邦股份

广州方邦电子股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),合计拟派发现金红利40,000,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.55%,不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司2020年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余伟宏	孙怡琳
办公地址	广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层	广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层
电话	020-82512686	020-82512686
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案。公司现有产品包括电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等,属于高性能复合材料。

其中电磁屏蔽膜是公司报告期内的主要收入来源。

2、主要产品及服务情况

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别,具有复杂结构的薄膜,具有抑制电子元器件电磁干扰的功能,通过贴合于FPC产生作用。现代电子产品“轻薄短小”和高频高速化趋势更加明显,驱动着电子元器件及其组件内外部的电磁干扰、以及信号在传输中衰减问题逐渐严重,对电磁屏蔽膜的需求更大,同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为HSF6000和HSF-USB3两大系列。其中HSF-USB3系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜,具备自主研发的独特微纳结构,屏蔽效能进一步提高,同时可大幅降低信号传输损耗,降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

(2)极薄挠性覆铜板

挠性覆铜板(FCCL)是FPC的加工基材,由挠性绝缘层与金属箔构成。根据产品结构,挠性覆铜板可分为有胶三层挠性覆铜板(3L-FCCL)和无胶两层挠性覆铜板(2L-FCCL);根据产品厚度,每类挠性覆铜板又分为普通型和极薄型。

下游电子产品快速发展,推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高密度互连(HDI)技术要求也不断提高。极薄挠性覆铜板是实现高密度互连技术的关键材料之一,可大幅提升电子元器件组装密度并节约组装空间,并实现超细线路FPC的制备。公司使用自主核心技术生产的极薄挠性覆铜板,其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进,具有良好的加工性能。

(3)超薄铜箔

公司自主研发生产的超薄铜箔厚度最薄可至1.5μm,具备低表面轮廓、极高热稳定性、较高伸长率和抗伸强度、剥离力稳定可控等优异性能,包括带载体可剥离超薄铜箔、锂电铜箔以及普通软板铜箔等。

带载体可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板、HDI板的必需基材。目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10/10μm,用传统的减成法制程工艺无法制备,必须使用mSAP(半加成工艺),而mSAP必须使用带载体可剥离超薄铜箔。公司生产的带载体可剥离超薄铜箔具有厚度极薄、表面轮廓极低、载体层和可剥离层之间的剥离力稳定可控等特性,可满足mSAP的制程要求。

锂电铜箔是制备锂电池负极材料的必需基材,优质的锂电铜箔可提升锂电池能量密度。目前市场上锂电铜箔主流厚度为6μm,并逐步向4.0μm发展,公司生产的锂电铜箔可满足以上需求。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式,由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况,确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行ISO9000标准,采购价格确定方式主要采用询价模式。

2、生产模式

电磁屏蔽膜及导电胶膜产品的保质期为三个月,且需要冷藏储存,为减少库存及降低损耗,公司采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式,由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标,生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等,公司的产品为高端电子材料,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,上述生产环节均由公司自主完成,不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测,并对最终产品进行质量检验。

3、销售模式

报告期内,公司的销售模式为直销模式,直接客户为FPC厂商,最终用户为智能手机、平板电脑等品牌厂商,不存在经销的情形。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况,自行针对目标市场进行产品开发,为下游客户提供解决方案;另一方面,公司和下游FPC厂商以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系,形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后,由FPC厂商进行打样、工艺验证和基本性能测试,通过后由封装/终端品牌厂商进行整体性能测试,之后通过小批量试产,验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致,公司即可量产、销售。

4、研发模式

公司长期坚持自主创新,采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面,通过与下游终端厂商的技术交流,了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜等产品的个性化需求,进行定制式研发。在主动式研发方面,采用自主研发的各项指标,依靠自身积累的经验,根据市场需求,设计产品,生产部门配合研发实验室进行测试确认,不断优化实验方案,不断改进,最终确定方案进行小批量试产,试产成功后再进行大批量生产,逐步提升现有产品的性能。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985电子专用材料制造”。

(2)行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如芯片封装、高性能高精密线路板制备密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成“卡脖子”困境。近年来,国家颁布了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。2018年颁布的《战略性新兴产业分类》,明确将“电磁波屏蔽膜”、“高频微波、高密度封装覆铜板”、“PCB用高纯铜箔”、“高纯铜箔(用于锂电池)”等电子专用材料列为重点产品。

公司产品的直接下游客户主要为电路板厂商、覆铜板厂商、电池厂商等,终端客户主要为智能手机厂商、半导体芯片厂商以及新能源汽车厂商等。

PCB有“电子产品之母”之称,能实现电子元器件的相互连接,起中继传输作用。近年来,随着5G通讯、消费电子、汽车电子等行业的快速发展,PCB市场规模逐年扩大,根据Prismark的统计,2020年全球PCB产值已超600亿美元,在总体体量不断增长的同时,还呈现出技术不断升级的特点,表现为挠性板(FPC)、高密度互连板(HDI)、IC载板、类载板等高性能电路板需求持续放量,同时增入式无源元件的市场需求也在逐步显现。全球PCB产值、技术路线整体呈上升趋势,增大了对公司产品的市场需求。总体来看,电子专用材料市场增长前景可观,我国高端电子专用材料自给率仍较低,具有很大的成长空间。

公司生产的超薄铜箔可用于锂电行业,将主要受益于全球汽车电动化。为实施新能源战略,减少化石能源对世界环境的污染,目前全球主要国家纷纷设定了汽车电动化指标,美国加州提出2050年实现汽车零排放,德国提出2030年电动化率100%,法国提出2040年起不再使用化石燃料汽车,英国提出2035年电动化率100%。我国于2020年11月2日发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,同时大力推动“碳中和、碳达峰”各项工作,要求到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年1-10月我国新能源汽车销售为90万辆,仅占国内汽车销售总量的4.6%,未来市场空间巨大。据相关资料预测,至2025年全球电动汽车销量1401万辆,同比2019年200万辆有6倍增长空间,对动力电池的需求量为886GWh,同比2019年926Wh有近9倍增长空间。动力电池是新能源汽车的核心部件,新能源汽车产业高速发展将推动动力电池市场持续放量,锂电铜箔作为动力电池的负极材料,将迎来广阔发展空间。

(3)主要技术门槛

一方面,经过多年的技术攻关和研究试验,公司已经掌握了真空溅射、卷状电镀、精密涂布和化学合成等四大基础技术,拥有多项核心专利,进而衍生出聚酰亚胺表面改性处理、聚酰亚胺薄膜离子源处理、电沉积加厚和电沉积表面抗高温氧化处理等具体应用,构成公司基础技术平台,并可实现各技术间不同组合应用,支撑公司成为高端电子材料平台型企业。

另一方面,电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程,涉及的原料配方、生产工艺、品质控制均较为复杂,同时下游应用持续对产品提出更高技术需求,企业必须不断改进生产工艺,不断升级、改善自主研发的关键设备和原料配方。随着技术的进步,产品升级速度不断提升,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应市场的发展。

目前公司主要产品性能均处于国际先进水平,其关键技术难点及技术壁垒如下:

电磁屏蔽膜:屏蔽效能≥60dB,接地电阻≤200mΩ,同时满足极低插入损耗、轻薄、耐弯折、耐热耐化等严苛加工应用要求;

极薄挠性覆铜板:铜层厚度1.5-9μm,剥离强度≥10N/cm,尺寸稳定性(%)≤±0.08,同时满足耐热耐化等严苛加工应用要求;

带载体可剥离超薄铜箔:主要特点为厚度超薄、表面轮廓极低,铜层厚度1.5-6微米,铜层粗糙度0.5-2.0微米,剥离强度≥6N/cm(稳定可控),拉伸强度400N/mm2,延伸率≥5%;

锂电铜箔:主要特点为机械性能良好,表面轮廓低,厚度可定制化,M面粗糙度≤2.0μm,达因值≥36,拉伸强度≥300N/mm2,延伸率≥8%;

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司在行业内拥有较强技术水平,主要产品对标国外,满足供应链本土化

公司在全球电磁屏蔽膜领域具有重要的市场地位,全球市场占有率超过25%,位居国内第一、全球第二。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。

在极薄挠性覆铜板领域,目前该产品全球量产供应商主要为日本的东丽和住友。公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板,其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进,具有优异的加工性能。

在带载体可剥离超薄铜箔领域,目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔,其铜层厚度及表面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等关键指标达到世界先进水平。

(2)公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立了稳定的合作关系

凭借出众的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应,公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex等众多优质直接客户,并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切的技术交流与合作,在电磁屏蔽膜、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔等细分领域的影响力不断提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜将受益于5G通讯、汽车电子等行业的快速发展。5G环境下,以智能手机为代表的消费电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,其内部结构FPC使用量不断增加以提升内部组装密度,同时电子元器件之间的电磁干扰亦愈加严重,这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加,另一方面体现为电磁屏蔽膜性能提升的要求(如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗断裂性更强等)。

同时,国家能源战略不断推进,新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化趋势明显,如中控触摸屏集成化、高清化,车周探测传感器达大量应用,预计将打开电磁屏蔽膜新的市场空间。

(2)极薄挠性覆铜板

作为FPC的加工基材,挠性覆铜板将受益于FPC市场需求扩大及其细线化趋势。据Prismark数据及预测,近10年内,全球FPC产值规模不断扩张,复合增长率约3.3%,预计2022年全球FPC产值有望达到149亿美元;另一方面,各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,倒逼FPC线宽线距越来越精细,这加大了对高性能挠性覆铜板(如无胶二层FCCL、极薄FCCL)的需求,因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高,更能满足细线路FPC的加工制程。

目前,普通挠性覆铜板领域,技术成熟稳定,进入门槛相对较低,基本已达到充分竞争的市场状态。极薄挠性覆铜板是实现高互连密度技术的关键材料,是电子产品轻、薄、短、小、多功能、集成化方向发展重要材料。在极薄挠性覆铜板领域,我国的技术水平总体落后于日本,目前全球极薄挠性覆铜板市场主要被住友金属工业公司、东丽株式会社所占据。公司研发的极薄挠性覆铜板,可以显著提高剥离强度,在性能上已达到日本同类产品水平,公司是国内少数掌握极薄挠性覆铜板生产工艺的厂商之一。

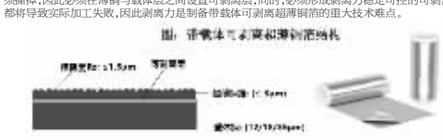
(3)超薄铜箔

公司量产的超薄铜箔包括带载体可剥离超薄铜箔、锂电铜箔等。

①带载体可剥离超薄铜箔是芯片封装基板(IC载板、类载板)、HDI板的基材,将受益于芯片制程先进化进程。

目前,半导体芯片技术快速发展、制程日益先进,客观上带动芯片封装领域的IC载板、类载板的细线化成为必然趋势,目前IC载板、类载板在线最小线宽线距已细至10/10μm,由于其线宽线距极细,用传统的减层法制程工艺无法制备,必须使用mSAP。mSAP是制备芯片封装基板、类载板的主流技术路线,目前,鹏鼎控股、深南电路、安捷利-美维电子、三星电机等国内外大型电路板厂商均主要采用mSAP制备IC载板、类载板等。

一般铜箔无法满足mSAP制程要求,必须用到带载体可剥离超薄铜箔。用于mSAP工艺的铜箔,必须满足以下关键条件:A.厚度≤3μm,若无法达到该标准,mSAP将无法稳定“闪蚀”过厚的铜层,届时将依旧存在减成法特有的“侧蚀”现象,无法制作精细线路;B.表面轮廓Rz≤1.5μm,若无法达到该标准,过高的铜层表面粗糙度闪蚀不掉,无法制作精细线路,同时也会严重影响IC载板、类载板的高频高速特性;C.必须带有载体层和可剥离层,由于薄铜太薄,无法直接应用于实际加工,必须依赖载体层加以辅助稳定;同时,实际加工过程中,只有薄铜最终应用到精细线路制作,载体层必须撕掉,因此必须在薄铜与载体层之间设置可剥离层,同时,必须形成剥离力稳定可控的可剥离层,剥离力过高或过低,都将导致实际加工失败,因此剥离力是制备带载体可剥离超薄铜箔的重大技术难点。



当前,国内外高端芯片龙头企业对带载体可剥离超薄铜箔存在较大需求,以实现先进制程芯片与基板的精密互连。然而,带载体可剥离超薄铜箔全球市场被日本三井铜箔垄断,卡脖子问题严重,对与我国高端芯片封装领域密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业造成较大制约,实现带载体可剥离超薄铜箔的供应链本土化需求较为迫切。

②锂电铜箔是超薄铜箔的另一重要应用方向。随着国家能源战略的深入推进,新能源汽车普及程度不断提升,对锂电池的需求越来越大、技术要求越来越高,推动着锂电铜箔的快速发展,目前锂电铜箔的厚度已来到4微米,预计还将追求更薄的厚度以进一步提高能量密度,超薄铜箔的技术空间、市场空间将得到进一步打开。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,782,356,827.47	1,571,154,765.64	13.44	452,580,090.69
营业收入	288,536,053.02	291,693,846.84	-1.08	274,707,377.26
归属于上市公司股东的净利润	119,230,719.02	128,658,027.01	-7.33	117,155,272.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,043,968.48	104,017,585.00	-17.28	111,923,253.21
归属于上市公司股东的净资产	1,609,714,651.11	1,522,552,177.42	5.72	414,854,527.78
经营活动产生的现金流量净额	145,057,113.85	129,936,444.01	11.64	125,392,531.14
基本每股收益(元/股)	1.49	1.88	-20.74	1.95
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.88	-20.74	1.95
加权平均净资产收益率(%)	7.65	14.50	减少6.85个百分点	31.08
研发投入占营业收入的比例(%)	15.77	11.63	增加4.14个百分点	7.88

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	63,430,544.51	82,619,179.65	68,415,604.21	74,070,724.65
归属于上市公司股东的净利润	34,800,828.27	31,003,462.39	29,719,763.13	23,706,675.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,380,240.65	27,839,976.26	20,322,966.76	13,500,784.81
经营活动产生的现金流量净额	13,649,717.67	47,089,109.98	16,942,512.04	67,375,774.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,268
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,374
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	18.19	14,555,802	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有限公司	0	14,086,260	17.61	14,086,260	0	无	0	境内非国有法人
广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)	0	7,200,000	9.00	7,200,000	0	无	0	其他
易红琼	-598,000	6,914,672	8.64	0	0	无	0	境内自然人
李冬梅	0	2,347,710	2.93	2,347,710	0	无	0	境内自然人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	2.50	2,000,000	0	无	0	其他
叶勇	-791,402	1,904,018	2.38	0	0	无	0	境内自然人
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	-4,239,604	1,606,196	2.01	0	0	无	0	其他
上海斐君投资管理中心(有限合伙)-广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,200,000	1.50	1,200,000	0	无	0	其他
夏登峰	-214,126	1,194,500	1.49	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东,合计持有公司47.73%股份;苏卿、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏卿与李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙);夏登峰是公司监事会主席,股东易红琼与董事刘西山为夫妻关系,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

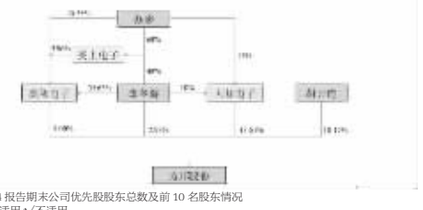
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司坚持以客户为中心,加强市场开拓力度,产品销量持续增长:实现营业收入288,536,053.02元,较上年同期下降1.08%;归属于母公司所有者的净利润119,230,719.02元,较上年同期下降7.33%。报告期内公司营业收入小幅下降的原因主要为销量增加,但为进一步扩大市场份额,适当降低了部分产品的价格;归母净利润小幅下降的原因主要为加快新产品开发而加大了研发投入,以及计提了股权激励费用。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

详情请见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更”。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将惠州力邦电子有限公司、东莞市惟实电子材料科技有限公司和珠海达创电子有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2021-012

广州方邦电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月20日(星期二)在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于2021年4月10日(星期六)以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长苏陟先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、田民波、金鹏、钟敏以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入288,536,053.02元,较上年同期减少1.08%;实现利润总额142,803,222.63元,较上年同期减少7.77%;实现营业利润142,504,088.37元,较上年同期减少4.02%;归属于母公司所有者的净利润119,230,719.02元,较上年同期减少7.33%;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规,勤勉尽责,督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策,公司整体经营业绩与上年持平;公司持续加大研发投入,进一步提升创新能力,紧抓新项目建设,拓宽业务布局,同时加强管理,提升公司盈利能力;公司股东大会、董事会、监事会及董事会下设委员会运作规范,各位董事勤勉尽责,均能按照规定出席会议并表决;公司认真落实信息披露工作,建立了规范透明的上市公司运作体系。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),截止2020年12月31日,公司总股本80,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利40,000,000元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.55%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-010)。

4、审议并通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果;在2020年年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2020年年度报告及摘要。

5、审议并通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司总经理根据公司的发展战略和经营计划,在募投项目建设、创新研发、生产经营等方面持续发力,取得良好成绩,董事会审议通过其工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》

经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控机构,聘期自2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-011)。

7、审议并通过了《关于确认公司2020年度董事薪酬及2021年董事薪酬方案的议案》

董事会确认了公司2020年度董事薪酬发放情况,同意了公司2021年度董事薪酬方案,公司独立董事津贴为7.2万元/年(税前),在公司任职的非独立董事执行岗位薪资,未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过了《关于确认公司2020年度高级管理人员薪酬及2021年高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会确认了公司2020年度高级管理人员薪酬发放情况,同意了公司2021年度高级管理人员薪酬方案,在公司任职的高级管理人员执行岗位薪资。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经核查,公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-011)。

10、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行审计委员会的职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面维续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,勤勉尽责,充分发挥各自专业优势,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2020年度独立董事述职情况报告》。

12、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

为降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响,综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司(含控股子公司)拟开展期货套期保值业务。合约价值不超过2亿元,套期保值业务的保证金最高余额不超过两千万元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-016)。

13、审议并通过了《关于制定商品期货套期保值业务管理制度的议案》

为规范公司商品期货套期保值业务,现制定商品期货套期保值业务管理制度,对公司商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定,严格控制业务风险。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

14、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2021年第一季度报告》。

15、审议并通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》

公司拟以自有资金人民币25,000万元对全资子公司达创电子铜箔项目进行追加投资,用于扩大项目生产建设及补充营运资金,达创电子注册资本不变。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议并通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月11日召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

17、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《广州方邦电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021年4月21日

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2021-014

广州方邦电子股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”、“大信”)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普